

# 酸铜光剂

## CHIBA-9Plus

### 药浴组成及作业条件

名称	范围	建议	消耗量
硫酸铜	150~230g/L	200g/L	
硫酸	50~90g/L	70g/L	
氯离子	60~150mg/L	100mg/L	
M	4~8ml/L	5ml/L	20~30ml/KAH
A	0.4~0.7ml/L	0.5ml/L	50~60ml/KAH
B	0.1~0.3ml/L	0.1ml/L	40~60ml/KAH
电流	1~5A/dm <sup>2</sup>		
浴温	25°C (20~40°C)		
搅拌	强烈、均匀的空气搅拌		
阳极	磷铜 (必须使用钛盐和阳极袋)		

### 特性

在9号的基础上改良提升更宽的操作范围, 清亮度, 耐温性, 低区光泽及延展, 并且更不易产生针孔麻砂。

### 应用范围

大五金件、锌压铸件、塑胶件、展示架等。

### 铜和硫酸

当铜或硫酸的浓度太低时高电位容易产生树枝状和烧焦。

### 氯离子

太低时会造成整平不佳甚至产生麻点。氯离子补可使用氯化钠 (氯离子 1mg/L=1.7mg/L) 或盐酸 (分析纯 37%) 即氯离子 1mg/L=0.0023ml/L。

### 光剂

M 太少—>整体光泽整平不足, 太多会出现白雾。

A 太少—>整体光泽会变弱, 太多高区容易有树枝状。

B 太少—>高区光泽不良, 过多低区光泽不良。

### 温度

最适合的温度为 25°C, 温度越高光剂消耗量会增加。

### 搅拌

搅拌不充分容易产生烧焦。

### 过滤

连续过滤, 使用活性炭会除去相当程度的光剂。

### 电流

必须以镀件的形状及作业条件等因素来决定; 密度不同则镀层特性及光剂的消耗量会改变; 密度低时镀层饱满度变差、内应力减少、硬度稍微提高。

### 管理方法

成分: 平时分析硫酸铜和硫酸的成分, 氯离子会随电解减少。

光剂: 消耗量会因电流密度、温度、汲出等因素不同而影响。

活性炭处理后须再重建新浴或补充适量的光剂。

### 包装规格

25kg/灰桶

